

# Instrukcja techniczna

*MC-Floor Connect*



# Spis treści

1. Obszary zastosowania .....	3
2. Aplikacja.....	7
3. <i>Obróbka końcowa</i> .....	13
4. <i>Narzędzia i maszyny</i> .....	14

Niniejszy dokument przedstawia wymagania dotyczące aplikacji i obróbki profilu łączącego MC- Floor Connect.



## 1. Obszary zastosowania

### Zalety

- ✓ Profil dylatacyjny zapewniający cichy i płynny przejazd pojazdów
- ✓ Możliwość stosowanie do istniejących powłok
- ✓ Szybka aplikacja i łatwy do naprawy

### Właściwości

- ✓ Wysoka odporność mechaniczna
- ✓ Trwale antykorozyjny
- ✓ Możliwość nanoszenia powłok/malowania
- ✓ Nadaje się do szlifowania umożliwiając całkowicie płynne przejście do otaczających podłoży
- ✓ Zapewnia ciągłą szczelność dla cieczy \*

\* deformacja dylatacji > 3 mm wymaga zastosowania dodatkowej taśmy łączącej, np. Mycoflex WW-Band

**Uwaga:** Należy określić zakres ruchu płyt bazowych. Przydatność wybranego profilu musi zostać sprawdzona przez eksperta. Należy upewnić się, że maksymalna szerokość dylatacji nie przekracza właściwości maksymalnej szerokości dylatacji profilu. Ponadto, w dylatacji nie mogą występować ruchy pionowe. Jeśli wystąpią ruchy pionowe, należy je skorygować pod płytami betonowymi poprzez dodatkową stabilizację płyt.

## Systemy MC-Floor Connect

System *MC Floor Connect*, oferujący trzy wersje profili dostosowanych do różnych wymagań, stanowi idealne, długoterminowe rozwiązanie dla wielu zastosowań. W rezultacie uzyskuje się odporne na uszkodzenia mechaniczne połączenie, po którym pojazdy mogą poruszać się cicho i bez wstrząsów.



MC-Floor Connect ST

Profil standardowy



MC-Floor Connect RC

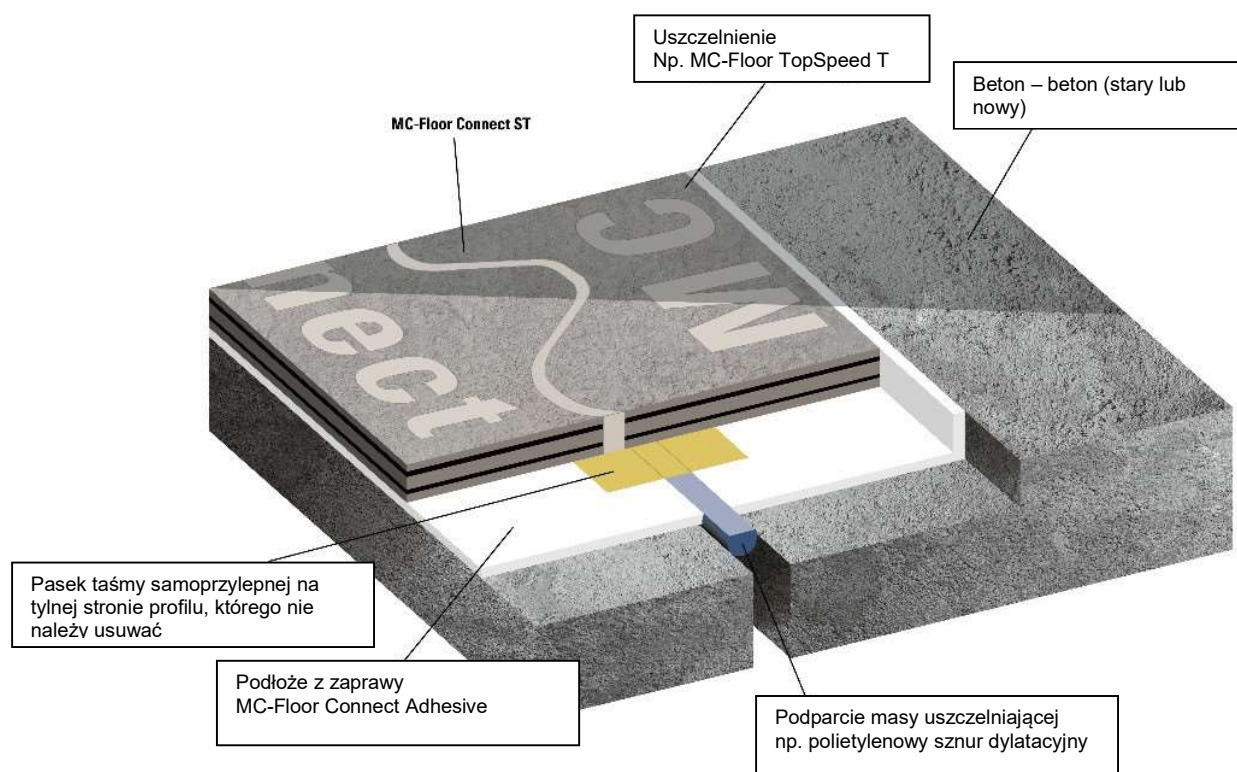
Profil nadający się do malowania

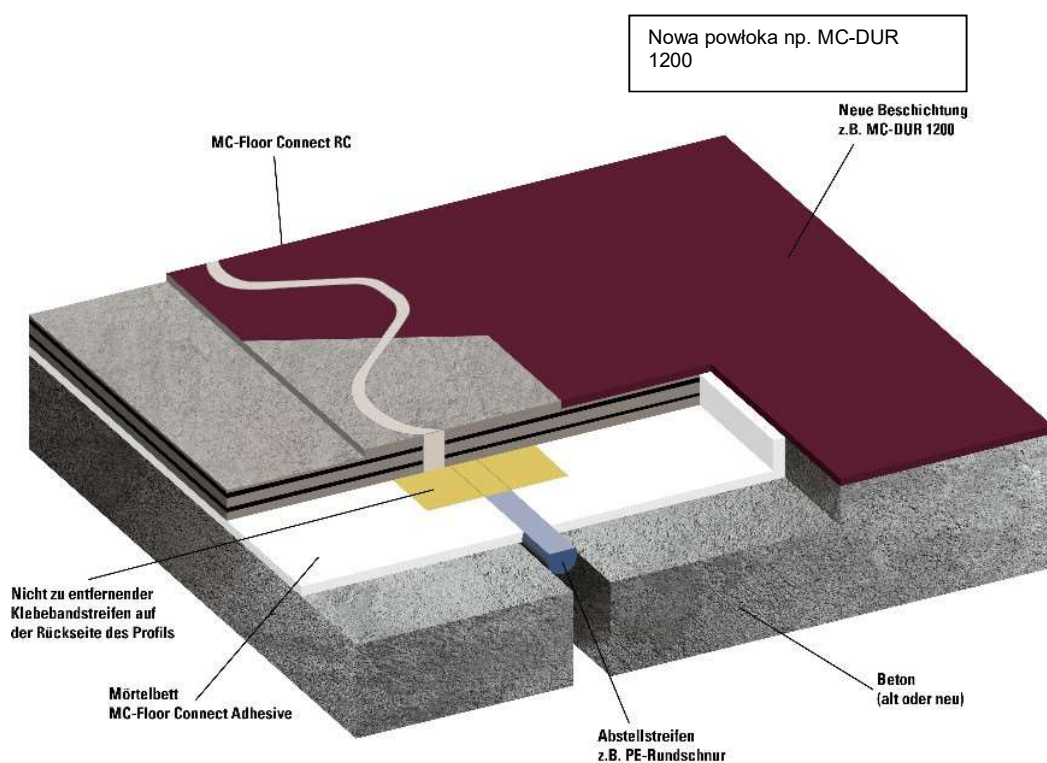


MC-Floor Connect CP

Profil dla parkingów

## MC-Floor Connect ST



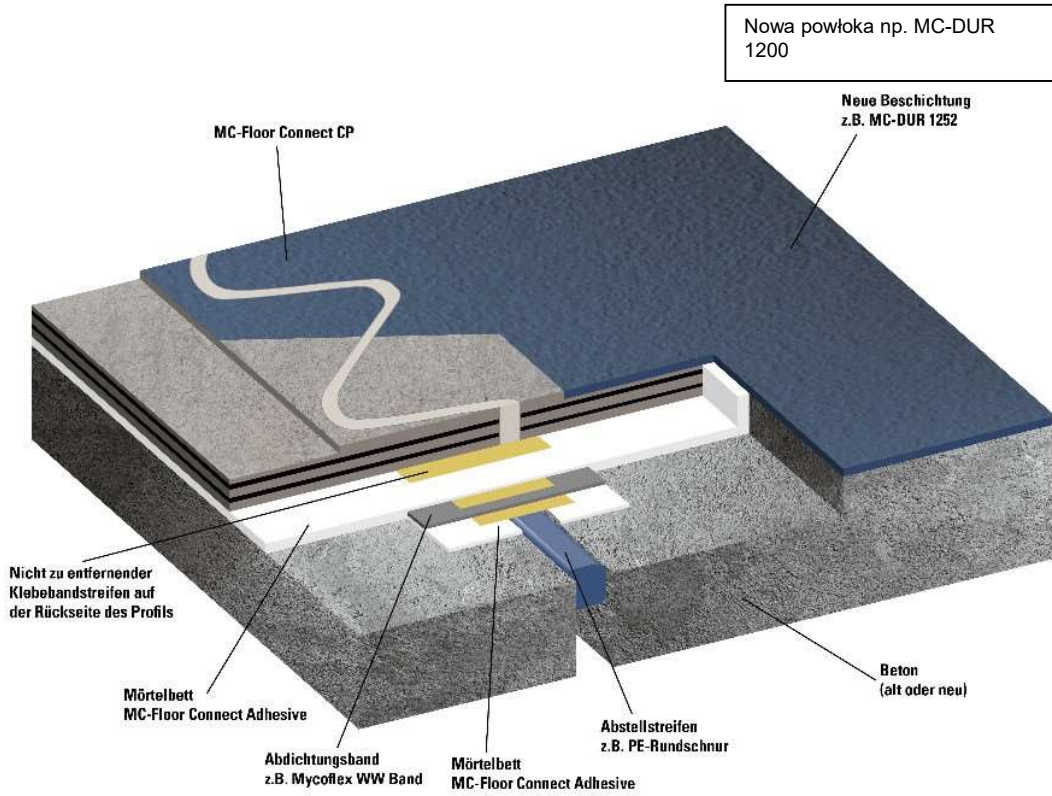


Pasek taśmy samoprzylepnej na tylnej stronie profilu, którego nie należy usuwać

Podłoże z zaprawy MC-Floor Connect Adhesive

Podparcie masy uszczelniającej np. polietylenowy sznur dylatacyjny

Beton – beton (stary lub nowy)



Pasek taśmy samoprzylepnej na tylnej stronie profilu, którego nie należy usuwać

Podłoże z zaprawy MC-Floor Connect Adhesive

Taśma uszczelniająca, np. Mycoflex WW Band

Podłoże z zaprawy MC-Floor Connect Adhesive

Podparcie masy uszczelniającej np. polietylenowy sznur dylatacyjny

Beton – beton (stary lub nowy)

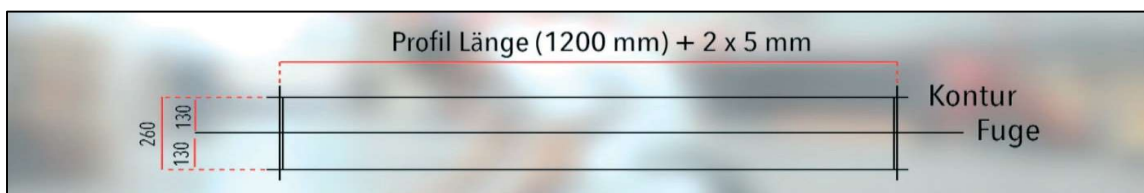
## 2. Aplikacja

### 2.1. Właściwa aplikacja

W zależności od stopnia nierówności otaczającego obszaru, profil należy ułożyć na nieco niższej lub równej wysokości co posadzka, aby umożliwić szlifowanie powierzchni w celu uzyskania gładkiej płaszczyzny. W procesie szlifowania można usunąć maksymalnie 3 mm profilu *MC-Floor Connect ST* i maksymalnie 2 mm profili *RC* i *CP*.

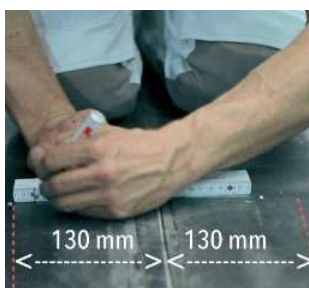
Jeśli beton ma tendencję do zakrzywiania się, obszary te należy wcześniej przeszlirować, aby uzyskać prawidłową wysokość. Ponieważ profil *MC-Floor Connect* może być szlifowany maksymalnie do 2 mm, konieczne jest umieszczenie go możliwie jak najbardziej równomiernie względem powierzchni.

W tym celu należy wykonać 3 ważne oznaczenia: szerokość i długość oraz nacięcia na złączach.



**Oznaczenie szerokości:** Dla *MC-Floor Connect ST* i *RC* należy zaznaczyć linie obustronnie w odległości 130 mm od środka złącza, natomiast dla profilu *CP* w odległości 135 mm (łącznie szerokość 270 mm).

**Oznaczenie długości:** Na każdym końcu złącza należy dodać 5 mm, aby listwa złącza była ona nieco dłuższa od stosowanego profilu.




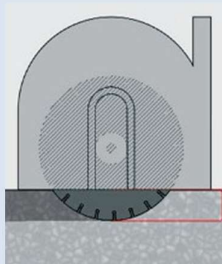
Wzdłuż długości listwy należy wykonać nacięcia co 2 cm, aby ułatwić późniejsze usuwanie betonu.

### 2.2. Cięcie podłoża

Cięcie podłoża wzdłuż zaznaczonych linii. Aby osiągnąć zaplanowaną głębokość wzdłuż całego cięcia, należy je wykonać nieco poza zaznaczonymi krawędziami linii.

**Przewidziana głębokość cięcia dla *MC-Floor Connect ST* wynosi ok. 23 mm, dla profili *RC* i *CP* ok. 20 mm. Jeśli planowane jest dodatkowe uszczelnienie taśmą Mycoflex WW-Band, do powyższych wartości należy dodać 3 mm.**



	<p>MC-Floor Connect ST: około 23 mm</p>	
	<p>MC-Floor Connect RC i CP: około 20 mm</p>	
	<p>Mycoflex WW-Band: + około 3 mm</p>	

Następnie należy rozbić podłoże mechanicznie. Można to zrobić za pomocą młota pneumatycznego.



Usuwanie betonowe podłoże za pomocą młota pneumatycznego, należy uważać, aby nie uszkodzić sąsiednich lub istniejących betonowych krawędzi zewnętrznych.

Należy kontrolować głębokość łoża profilowego na całej długości, tak aby nie spadło poniżej wartości minimalnej. Można to zrobić na przykład za pomocą skrobaka o regulowanej wysokości.



Ewentualne wbudowane profile metalowe należy usunąć na głębokość co najmniej 25 mm.

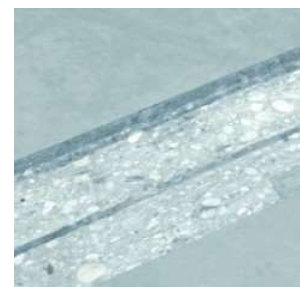
### 2.3. Czyszczenie i przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (maks. 6% wilgotności), wolne od wszelkich substancji powodujących odspajanie, takich jak kurz, olej itp.

Jeśli podłoże betonowe uległo zbyt głębokim pęknięciom w obszarze złącza (> 10 mm), obszar ten musi zostać ponownie wyprofilowany w ramach osobnej operacji.

Wytrzymałość podłoża na rozciąganie musi wynosić co najmniej 1,5 N / mm<sup>2</sup>.

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić co najmniej + 8°C i maks. + 30°C (Uwaga: należy zwrócić uwagę na punkt rosy- skraplanie!).



## 2.4. Cięcie

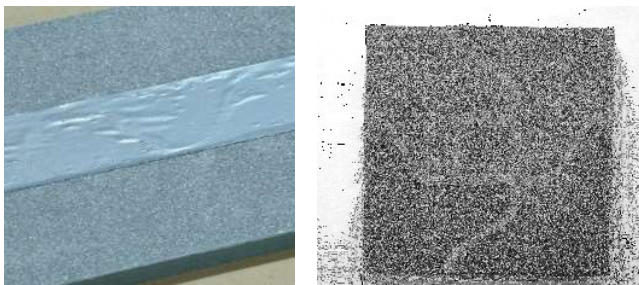
Profil należy przyciąć do odpowiedniej długości za pomocą szlifierki kątovej. Na tylnej powierzchni profilu w polu krzywej *MC-Floor Connect* należy nałożyć pasek smarujący, aby zapobiec wnikaniu kleju w złącze i uzyskać optymalny poślizg złącza.

**Paska tego nie wolno usuwać.**

W celu sprawdzenia czy profile dylatacyjne zostały prawidłowo przycięte, należy je przetransportować na miejsce montażu i wstępnie ułożyć. Upewnić się, że krzywa ułożonych profili dylatacyjnych jest ciągła.

Następnie, profile należy usunąć i składować obok miejsca ich montażu.

Profile narożne i elementy do połączeń w kształcie litery T i przecięć należy zakupić oddzielnie dla wszystkich systemów *MC-Floor Connect*.



## 2.5. Wypełniacz

W celu zapewnienia ruchu między dwiema płytami bazowymi należy użyć pianki wypełniającej. Wysokość warstwy wypełniającej powinna wynosić około 2 mm. Zaprawa, która jest nakładana w następnej kolejności, nie może wypełniać istniejących połączeń betonowych. Wysokość należy kontrolować w sposób ciągły za pomocą pływaka o regulowanej wysokości.



## 2.6. Przygotowanie zaprawy

*MC-Floor Connect Adhesive* to dwuskładnikowa zaprawa dostarczana odważona w wiadrach. W pierwszej kolejności składnik bazowy jest dokładnie mieszany. Następnie dodawany jest utwardzacz. Oba składniki miesza się przez co najmniej 3 minuty w celu uzyskania jednorodnej mieszanki. Zalecamy stosowanie mieszadeł wolnoobrotowych (maks. 300 obr./min). Należy zapobiegać przedostawaniu się powietrza poprzez staranne mieszanie. Po zakończeniu mieszania materiał należy przenieść do innego pojemnika i ponownie wymieszać. Zaprawę można teraz rozprowadzić za pomocą pacy lub podobnych narzędzi.



## 2.7. Mycoflex- WW-Band

Profile *MC-Floor Connect* są dostarczane już uszczelnione. To złącze konserwacyjne służy utrzymywaniu profilu w czystości i zapewnia wodoszczelność tylko w przypadku ruchu złącza mniejszego niż 3 mm. W przypadku większego ruchu złącza, aby zachować wymaganą szczelność, pod profilem *MC-Floor Connect* należy wykonać uszczelnienie za pomocą taśmy *Mycoflex WW-Band* i kleju *MC Floor Connect*. Taśma *Mycoflex WW-Band* o szerokości 150 mm. Zachodzące na siebie taśmy łączące są grzewane na gorąco.



MC WW-Band



Taśmę *Mycoflex WW-Band* należy zakleić na środku szeroką taśmą samoprzylepną o szerokości co najmniej 5 cm przed dopasowaniem przodu i tyłu, tak aby od 33% do 50% pozostawało wolne od kleju *Mycoflex*. Taśma pełni funkcję paska oddzielającego. Klej *MC-Floor Adhesive Connect* zostanie nałożony na betonowe podłoże i powierzchnię taśmy *Mycoflex WW* stykającej się z betonem.

Następnie należy przykleić taśmę *Mycoflex WW*, uważając, aby powstały pory. Nie należy usuwać taśmy samoprzylepnej.

## 2.8. Nakładanie zaprawy

Rozprowadzić przygotowaną zaprawę równomiernie i jednorodnie w lewej i prawej połowie szczeliny. Wygładzić klej kompozytowy na wymaganą grubość warstwy za pomocą szpachelki o regulowanej wysokości. Bardzo ważne jest, aby zachować odstęp między lewą i prawą stroną złącza.



## 2.9. Montaż profilu *MC-Floor Connect*

Przed położeniem profilu *MC-Floor Connect* w łożu wypełnionym zaprawą, należy nałożyć zaprawę montażową na całą tylną powierzchnię profilu dylatacyjnego.



Ma to na celu zapewnienie, że pod profilem nie pozostaną żadne puste przestrzenie ani pory w warstwie zaprawy. Profil należy wcisnąć w łożo klejowe. Nadmiar zaprawy wypłynie po bokach. Jeśli używane są narzędzia, zaleca się stosowanie gumowego młotka w połączeniu z kantówką, aby zapewnić prawidłowy rozkład siły.



Szczeliny boczne należy następnie wypełnić zaprawą montażową, aby uniknąć jakichkolwiek porów lub pustych przestrzeni.



Należy upewnić się, że krzywa na profilu *MC-Floor Connect* jest ciągła i nie jest sklejana zaprawą. W tym obszarze należy zastosować elastyczną masę szpachlową, taką jak *Mycoflex 488 MS*, jako wypełniacz.

## 3. Obróbka końcowa

### *3.1. Szlifowanie*

Stosując klej *MC-Floor Connect* w temperaturze 20°C, można obciążać profile *MC Floor Connect* już po 24 godzinach od montażu. Aby zapewnić równomierne przejście między klejem *MC-Floor Connect* a otaczającymi go powierzchniami, całość należy przeszlifować, na przykład za pomocą szlifierki ręcznej. Szlifowanie można rozpocząć dopiero po utwardzeniu kleju. Profil *MC-Floor Connect ST* można szlifować maksymalnie do **3 mm**, a profile *RC i CP* maksymalnie do **2 mm**. Aby uniknąć powstawania otworów lub śladów szlifowania, należy wykonywać obszerne ruchy okrężne. Uzyskanie gładkiej powierzchni wymaga zastosowania odpowiedniej tarczy szlifierskiej.



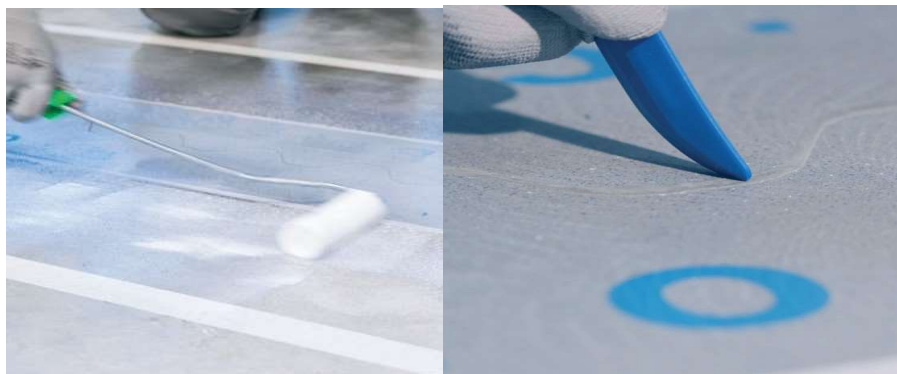
Zeszlifowane połączenie profili

### *3.2. Uszczelniacz lub powłoka*

*MC-Floor Connect* można wizualnie dopasować do otaczającej posadzki za pomocą barwionej powłoki nawierzchniowej.

Zeszlifowany obszar należy przynajmniej uszczelnić przezroczystym uszczelniaczem, takim jak *MC Floor TopSpeed T*, aby ograniczyć wnikanie brudu i cieczy.

Podczas nakładania powłoki na profil należy upewnić się, że uszczelniacz na profilu nie został pokryty powłoką lub został z niej usunięty natychmiast po nałożeniu.



Uszczelniacz

Usuwanie uszczelniacza

## 4. Sprzęt do montażu profili łączących MC Floor Connect



Waga

Poziomica: Długość 200 cm i 50 cm

Ołówek / Marker

Kreda

Taśma

Folia osłonowa

Mieszadło

Waga

Środek czyszczący EP

Szczotka

Frez do rowków z odsysaniem ( zalecany: Hilti DCG 230)

Frezarka do betonu ( jeśli potrzebna)

Odkurzacz (zalecany: Hilti VC 40-U)

Młot pneumatyczny

Łom

Młotek murarski

Kielnie tynkarskie i różne packi

Młotek gumowy

Drewniana deska 5 x 8 cm, długość ok. 40 cm

Szlifierka kątowna z odsysaniem i tarczami diamentowymi ( zalecana: Reka diamop Basic)

Wałek z krótkim włosiem

Uszczelniacz silikonowy



MC-Bauchemie Sp. z o.o.

63-000 Środa Wlkp

Ul. Prądyńskiego 20

Telefon: +48 61 28 64 500

Karta Techniczna dostępna na stronie : [www.mc-bauchemie.pl](http://www.mc-bauchemie.pl)